

機関投資家・アナリスト向け SEMI 事業説明会 質疑応答録

日時 : 2026 年 9 月 10 日 (木) 13:00~14:30

登壇者 : ヤマハ発動機株式会社 執行役員 ソリューション事業本部長 江頭 綾子
ヤマハロボティクス株式会社 代表取締役社長 中村 亮介

【事前質問】

競合他社と比較した際の半導体製造後工程装置 (SEMI) の優位性および市場シェアについて。

当社の優位性は、ワイヤボンダ、フリップチップボンダ、モールディングといった強いコアプロセス技術を持ち、これらをトータルで一貫提供できることである。シェアは、半導体製造後工程装置メーカーとしてはグローバルで 11 位、モールディング装置は業界第 2 位、ワイヤボンダは業界第 3 位である。

半導体製造後工程装置の顧客構成について。

大手ファウンドリー、IDM、OSAT のお客様にグローバルで販売を行っている。

【質問者 A】

SEMI 事業の業績状況と中期経営計画の 2027 年目標達成に向けた見通しについて。

SEMI 事業では、モールディング装置やワイヤボンダを中心に好調な受注を獲得している。一方、売上計上は下期に偏る傾向があるため、受注増加が上期売上には十分反映されていない。下期の売上拡大を通じて、中期経営計画で掲げた目標達成を目指していく。

中期経営計画で掲げている ROS 目標達成に向けた取り組みについて。

表面実装装置 (SMT) については、上期は AI サーバー向け需要の拡大が業績を牽引した。今後も大手 EMS メーカー向けの拡販を進めるとともに、固定費削減やコストダウン活動を推進し、収益性向上に取り組んでいく。こうした取り組みは SEMI 事業でも同様に進めている。

SEMI についても、受注環境は堅調に推移している。タイ工場におけるワイヤボンダのコストダウンや、モールディング装置のリードタイム短縮などを進め、生産性向上による利益改善に取り組んでいる。

SEMI 事業の今期および来期の業績見通しについて。

今期については、中期経営計画で想定した水準に近い売上水準を見込んでいる。足元では受注が堅調に推移しており、まずは受注を着実に売上・利益につなげていく。来期の見通しについては現時点で具体的な言及は控えたい。

【質問者 B】

ワンストップスマートソリューションの強みは。

当社は SEMI と SMT に加え、産業用ロボットの事業がある。各顧客の生産現場や工程を深く理解している強みを生かし、これらの製品ラインナップを組み合わせながら、工場全体の自動化を提案できる点が当社の強みである。このワンストップスマートソリューションは SMT を中心に進めているが、SEMI においても、ワイヤボンダとモールディング、フリップチップボンダとモールディングなど、一つの

引き合いで複製製品の受注につながるクロスセルの実例は複数ある。

ヤマハロボティクスホールディングスのワンストップスマートソリューションやクロスセルの効果は今後拡大していくか。

効果が出るまでのステップは3つ。はじめに、各プロセスで強みをもつ新装置を開発すること。次に、その装置を一貫提供し、クロスセルにつなげること。最後に、装置間の連携を可能にする機能群を開発し、ソリューションとして提供することである。当社は既に、新技術を用いた装置の一貫提供とクロスセルを展開している。装置間の連携についてもワイヤボンダとモールディングの連携に加え、ワイヤボンダとワイヤ検査機との連携など、第3ステップの取り組みを進めている。

SEMI 事業は今年の売上目標が前年比 14～15%の伸長となる。市場成長についていけているか。

モールディング、ワイヤボンダについては市場を超える成長ができています。フリップチップボンダについては、現在顧客評価が進んでおり、評価完了後には、新たな成長ドライバーになると期待している。

【質問者 C】

SEMI 事業の収益性とリードタイムについて。

ヤマハロボティクスは2021年の構造改革以降、継続して黒字を維持している。利益率は年々改善しており、コーポレート費用配賦前の利益率は2桁%に近い水準。2027年は利益率15%を目標としており、今期・来期にかけてさらなる収益性向上を目指す。受注から売上計上までの期間は、ワイヤボンダで約4～10カ月、フリップチップボンダおよびモールディング装置で約8～14カ月が目安となる。

2027 年売上目標 500 億円達成に向けて生産能力は十分か。

2027年の売上目標500億円に対応する生産能力はすでに確保済み。一方、次の成長目標である売上1,000億円の達成に向けては生産設備の拡張が必要となる。

長野県の金型会社買収など成長市場への先行投資を進めており、足元の受注拡大にもつながっている。

ロボティクス事業とヤマハ発動機全体のシナジーについて。

ロボティクス事業は二輪車・マリン事業とは異なる収益サイクルを持ち、事業ポートフォリオの分散による収益安定化に貢献している。また、ヤマハ発動機の生産現場で培った自動化やDXの知見をロボティクス事業に活用し、その成果を外部顧客向けソリューションとして展開することで、モノづくり領域でのシナジーを創出している。

【質問者 D】

SMT 事業の AI 関連需要の状況と今後の機会について。

AI サーバー市場の拡大を背景に、大手EMSメーカーで当社製品の評価が進んでいる。車載向けに培ってきた大型電子部品の実装技術がAIサーバー向け基板のニーズと合致しており、量産化に向けた評価が順調に進捗している。今後も大手EMSメーカー向けの拡販を進め、中期経営計画の目標達成を目指していく。

SMT 事業の成長見通しについて。

生成AI関連需要に加え、自動車関連分野でも自動化やコネクテッド化の進展による需要拡大が期待される。これらの市場機会を取り込みながら、更なる成長を目指していく。

SEMI 事業における顧客評価から採用までのプロセスと案件獲得確度について。

SEMI 業界では、書類審査や実機評価を経て採用可否が判断される。現在、ワイヤボンダやモールディングについて複数の顧客で評価が進んでおり、新製品は市場から良好な評価を得ている。今後も生成 AI 関連需要など、市場成長を取り込みながら売上・シェア拡大を進めていく。

【質問者 E】

今後の投資規模は。

SMT は、浜松事業所を 2024 年に増築しており、需要拡大に対応するための生産能力は確保済み。SEMI については、2025 年ニデックプレジジョン・ヤマダを買収し、アピックヤマダ・プレジジョン（AYP）を設立し、金型の生産能力を向上させた。同時にモールディング装置の生産エリアを拡大し、11 月からは組み立てのキャパシティも拡大させる。投資額については、AYP 買収や工場の改修等で十数億の投資を行ってきた。特に今後 SEMI の領域では、研究開発でも先行的な投資が必要になる。

【質問者 F】

先端半導体向けの成長見通しについて。ボンディングとモールディング装置のどちらが成長を牽引するのか。また、ワンストップスマートソリューションが評価されているポイントは何か。

モールディング装置は、現行の先端半導体向け樹脂成形プロセス向け需要が堅調に拡大しており、加えて次世代プロセスでも高評価を獲得し始めていることから、足元・中長期ともに成長が期待される。ワイヤボンダも、新型装置のコンパクト性、高速性、省エネ性能が評価され、市場拡大を背景にシェアを伸ばしている。フラップチップボンダは顧客評価の段階にあるが、評価は良好で、今後の成長ドライバーとして期待している。

トータルソリューションについては、特に一般半導体分野ではワイヤボンダからモールディング装置までを一括で任せたいというニーズが強い。先端半導体分野でも、サービス・サポート力が評価されており、モールディング装置とフラップチップボンダを組み合わせた提案への引き合いが増えている。

中期経営計画で掲げている 2027 年売上 500 億円から 2030 年 1,000 億円への成長目標は、どの程度確度があるのか。

モールディング装置とワイヤボンダについては、成長シナリオの実現可能性は高いと見ている。フラップチップボンダは顧客評価の最終段階にあり、評価が順調に進めば、中期経営計画達成の確度向上に加え、さらなる成長余地の創出につながると考えている。

以上